

2023.08.02 新製品リリース

面積生産性2倍^(※1)を実現した半導体パッケージ用「はんだボールマウンタ、Nシリーズ」の販売開始のお知らせ

AIメカテック株式会社(本社:茨城県龍ヶ崎市向陽台、社長:阿部 猪佐雄)は、半導体パッケージ事業の新たな提案として、新製品「半導体パッケージ用はんだボールマウンタ、Nシリーズ」の販売を開始します。

当社は、先端半導体パッケージ向けGシリーズに加え、標準半導体パッケージ市場をターゲットに本装置を開発致しました。長年培ったボール搭載技術に当社の開発力とものづくり力を融合し、面積生産性2倍^(※1)を低コストで実現、更にダークボールの検査を標準装備致しました。現行のGシリーズと新製品Nシリーズにより、半導体パッケージの全市場に対し提案してまいります。

5G、IoT、AI市場などの成長を背景に、生産性、コスト及び環境に優れたはんだボール搭載法のニーズは増加してきております。特に標準半導体パッケージ市場においては、コストと面積生産性向上のニーズが高まってきており、フラックス印刷、ボール搭載、検査、リペア工程に対しワンストップソリューションで新製品Nシリーズを提案してまいります。

海外展示会において半導体顧客に対し既にPRを開始し、引合も具体化してきております。ウエハ用及びサブストレート基板用を同時にリリースし年間20ライン以上の販売を見込んでおります。

弊社は、今後も製造プロセスのイノベーションを通してより便利で豊かな生活スタイルの向上により社会に貢献できる企業を目指して参ります。

※1) 面積生産性:設置面積に対する生産量、数値は当社比を示す。

お問い合わせ

AIメカテック株式会社
営業部 TEL:0297-62-9119
<https://www.ai-mech.com/>



新製品 はんだボールマウンタ、Nシリーズ (外観)